

烟台德邦科技股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案

烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，于 2024 年 06 月 26 日发布了《烟台德邦科技股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。根据行动方案内容，公司积极开展和落实相关工作，深度聚焦主营业务，深挖市场潜力，全力拓展市场规模；大力提升科技创新能力，以创新驱动产品市场竞争力提升；不断优化内部运营管理、精细管控业务各环节，全面提高经营质量与效率。通过一系列有力措施，稳步推动公司经营成效提升，在保障投资者权益、树立良好公司品牌等方面取得了一定成效。

2025 年度，董事会紧密结合行业发展趋势与公司实际经营情况，制定了《烟台德邦科技股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案》，以持续推动公司稳健前行。

公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案执行情况及 2025 年度行动方案主要举措如下：

一、聚焦核心业务，深挖下游市场价值

公司始终专注于高端电子封装材料的研发和产业化，聚焦集成电路封装材料、智能终端封装材料、新能源应用材料、高端装备应用材料四个发展方向，实施“1+6+N（New）”的市场发展战略，以“集成电路封装到智能终端封装等电子系统封装”为一个主链条，重点贯穿集成电路封装、智能终端模组、平面显示、新能源动力电池、光伏电池、高端装备 6 个细分应用市场，在半导体先进封装等新兴（N）细分市场通过资本整合，拓展新领域，实现快速发展。公司凭借卓越的技术实力和创新能力，荣获国家专精特新重点“小巨人”企业和“国家知识产权示范企业”称号。2024 年度获得“国家级制造业单项冠军企业”荣誉称号。

2024 年，公司持续加大新产品研发投入，产品系列得到进一步的完善；持续推进原有产品技术提升，产品竞争力得到进一步的巩固提升；持续加大市场开拓力度，新应用和新客户不断增多；持续优化内部管理体系，业务效率不断

提升；持续高质量推进募投项目建设，新增产能有效满足增量业务的需求。报告期内，公司所处各细分市场挑战与机遇并存，半导体行业复苏带动下游稼动率回升，消费电子行业全年小幅增长，新能源汽车继续保持较快发展势头，人工智能、人形机器人等新兴产业蓬勃发展。公司深耕市场，紧抓机遇，全年实现营业收入 116,675.21 万元，同比增长 25.19%。

2024 年，公司集成电路、智能终端、高端装备板块的毛利率保持稳步上升态势，新能源板块毛利率则有所降低，综合毛利率略有降低。公司持续加大海内外市场开发、IT 建设、技术研发以及对核心人员的激励等方面的投入，相关费用支出同比有所增加，全年实现归属于母公司所有者的净利润为 9,742.91 万元，同比下降 5.36%。

2025 年，公司以“高效运营、高质量发展”为目标，全面贯彻稳中求进的总工作方针，持续加强科研创新力度，提升数智化、人才梯队建设水平，推动经营业绩的稳步提升，同时布局第二增长曲线，并以投资并购、加速国际业务落地拉动企业非有机增长，进一步拓展增长空间，提升回报水平。

在国内市场，公司将紧密围绕国家产业政策导向，抓住国内产业升级契机，加大市场开拓力度，为国内客户提供优质产品与服务，深度融入国内产业链。在国际市场，公司将积极参与国际竞争，以客户需求和市场发展趋势为导向，进行全球化布局，以东南亚等地区为海外布局基础点，逐步挖掘海外潜力市场，切实推进业务落地与市场渗透，提升企业品牌价值及影响力。国内国际双轨并行模式，将使公司充分利用国内外两个市场、两种资源，实现资源最优配置，提升整体运营效率与经济效益，为社会创造更多财富与价值。

二、持续加大研发投入，强化科技创新驱动

2024 年度公司研发投入达 6,685.02 万元，较上年同期增长 7.90%，研发费用占营业收入比例为 5.73%。持续增长的投入，为技术创新与产品升级提供资金保障，助力公司凭创新产品提升市场竞争力与品牌影响力。公司高度重视科研人才队伍的建设，加大引才力度、完善培养体系，打造高水准的科研队伍，为研发项目推进、技术突破提供人才支撑。2024 年公司共拥有国家级海外高层次专家 2 人，研发团队扩充至 155 人，同比增幅为 15.67%，占公司总人数的 20.53%。

2024 年公司加快推进科研成果转化与应用，申请国家发明专利 70 项，新获授权发明专利 28 项。主要研发成果包括：用于 SSD 固态硬盘的双组份高导热凝胶、导电固晶膜(Conductive Die Attach Film, CDAF)、用于高速大芯片倒装封装的高性能底部填充胶(Underfill)、LIPO 立体屏幕封装技术应用光敏树脂材料及 PUR 产品的创新突破。其中 LIPO 立体屏幕封装技术应用光敏树脂材料已为小米手机最新屏幕工艺“LIPO 立体屏幕封装技术”量产供货，并获小米科技颁发 2024 年度“合作创新奖”。PUR 产品持续推出了一系列具有竞争力的新技术与新产品，生物基、高导热、超软、磁热、耐黄变、耐化学品、UV 压敏型 PUR、低表面能粘接等技术的创新突破，满足了客户的多元化需求，公司由此荣获华为公司颁发的 2024 年“技术突破奖”。

2025 年度公司继续以“技术为引领、人才为驱动”，加快完善技术平台、产品平台、应用测试平台三大平台，深化电子级环氧、丙烯酸、聚氨酯、有机硅、聚酰胺五大原材料体系研发深度，满足客户多应用场景需求，并配套技术服务能力，形成“产品+技术+服务”的三维一体核心竞争力；强化高校院所与企业联合体作用，结合行业发展趋势加大技术储备，瞄准前沿技术与行业头部客户开展战略合作，推动行业发展与技术进步。

技术创新是公司发展的核心动力，也是推动提质增效的关键因素。在高端封装材料领域，为打破技术壁垒、提升产品品质，公司将持续加大创新投入，计划进一步增加研发资金，广泛吸引全球行业顶尖人才，组建更为专业、强大的研发团队，深入开展前沿技术研究。目前，公司募投项目之一的“新建研发中心建设项目”正在有序推进，建成投用后将大幅提升公司研发实力。公司将以新建研发中心为平台，依托公司的研发团队，整合行业优质的技术研发资源，对行业前沿性技术进行深入的研究，提高公司后端技术及工艺研发对前端产品生产的支持服务能力。

三、完善公司治理，筑牢高质量发展根基

2024 年度，公司持续完善治理建设，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规，深入开展内部管理制度的优化升级工作，修订完善了《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《募集资金管理办法》《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》等制度，进一步增强

公司内部控制水平。

公司始终重视控股股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的规范履职工作，及时传达监管动态和法规信息。2024 年公司内部组织对董监高进行了“独董新规、国九条、新公司法”等相关监管新规的培训；组织相关人员参加证监会、山东证监局、上海证券交易所、上市公司协会等组织的专项培训及内部培训，强化控股股东、实际控制人及董监高等“关键少数”合规意识，并确保“关键少数”及时了解最新法律法规，提升履职能力，切实推动公司高质量发展，维护全体股东的利益。

2025 年，公司将持续优化完善内部控制和公司治理，提高公司运营的规范性和决策的科学性，保障全体股东的合法权益。

持续夯实公司合规管理根基，结合新颁布的《公司法》和新监管政策，及时修订完善《公司章程》及配套治理文件，推动提升公司内部约束机制的有效性。制定系统的培训计划，组织全体董监高及相关人员，积极参与监管机构、行业协会举办的各类专业培训，密切跟踪资本市场动态，深入学习证券市场法律法规，全面掌握证券市场知识，精准把握监管动态，进一步增强自律与合规意识，保障公司持续规范运营，全年集体培训学习不少于 2 次，确保学习的持续性和有效性。

四、加强投资者沟通，提升信息披露质量

公司高度重视信息披露工作，树立以“投资者为本”的上市公司发展理念，通过信息披露提升公司治理水平、增强市场透明度、树立良好企业形象。

2024 年，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司信息披露管理相关制度的规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、有效地披露了公司定期报告、临时公告等重大信息。为加强与投资者的沟通交流，公司已通过上证路演中心召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会、2024 年半年度业绩说明会、2024 年第三季度业绩说明会，并开展多场投资者交流活动，接受现场参观及调研活动，并及时披露《投资者关系活动记录表》。公司还通过投资者热线电话、公司公开邮箱、上证 e 互动平台，与投资者保持密切沟通，在合法合规范围内及时回复投资者关心的问题。

2025 年，公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，在此基础上，进一

步提高信息披露内容的可读性和有效性，并继续做好内幕信息管理工作，切实维护好投资者获取信息的平等性。与此同时，公司将进一步优化投资者关系管理的工作机制和内容，丰富宣传途径和交流形式，探索构建多元化双向沟通渠道，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的目的。2025 年内公司计划开展不少于 3 次业绩说明会/投资者接待日，开展线下/线上调研活动，邀请投资机构、分析师及有兴趣的投资者，现场参观公司的生产线、研发及办公区域等，更加直观、贴近感受公司发展情况。通过多种形式与投资者进行交流，使投资者全面及时地了解公司运作模式、经营状况、发展战略等情况。

五、不断健全投资者回报体系，增强投资吸引力与价值

1、现金分红

公司坚持实施积极的利润分配政策，始终将投资者利益放在首要位置。公司依据上交所现金分红相关规则指引、市场同行业上市公司分红水平，并结合公司发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，合理制定现金分红政策。自 2022 年公司上市以来，保持每年实施现金分红，至今已累计分红达 7,801 万元（含税），为投资者带来长期投资回报，增强投资者价值获得感，公司以良好、持续和稳定的现金回报水平充分保障全体股东的基本利益。

2025 年 4 月 18 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份 140,912,842 股为基数（截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本为 142,240,000 股，扣除回购专用证券账户中股数 1,327,158 股后的股本为 140,912,842 股），拟派发现金红利总额人民币 35,228,210.50 元（含税）。

2、股份回购

2024 年，公司基于对未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，累计回购股份 1,242,958 股，支付的资金总额为人民币 4,980.45 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），通过回购公司股份的方式提振市场信心，维护股价稳定。

为继续践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护公司全体股

东利益，促进公司持续、稳定、健康发展，公司基于对未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，于 2025 年 4 月 4 日发布了第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告，拟以人民币 4,000~8,000 万元（含）的资金总额回购公司股份。

六、动态优化行动策略，积极履行社会责任

提高上市公司质量，增强投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，也是上市公司对投资者的应尽之责。在新的一年里，公司将积极推动并落实 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，并定期评估行动方案的执行情况，在充分听取投资者关于改进行动方案意见建议的基础上，进一步明确具体可行的改进措施，以良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，为共建共享共担的资本市场新生态贡献自己的力量。

本方案是公司基于目前实际情况做出的计划，未来可能会受到国内外市场环境、政策调整等因素影响，存在一定的不确定性，有关公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

烟台德邦科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日